

中信证券股份有限公司
关于有研半导体硅材料股份公司
2024 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 3 月 24 日-2025 年 4 月 11 日等日期对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2024 年度审计报告、关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

（4）查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

受世界经济增长动能不足、地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发、国内结构调整持续深化、半导体市场形势波动等诸多因素影响，公司未来经营业绩存在下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、技术迭代风险

公司是我国率先实现6英寸和8英寸硅片规模化生产的企业，但与全球排名靠前的前五大硅片制造企业相比，在先进制程产品种类、客户认证、应用领域等方面仍存在较大差距。随着全球科技进步，半导体行业快速发展，对半导体硅片的技术指标要求也在不断提高，若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品开发未能满足下游客户需求，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）经营风险

1、供应链风险

公司积极推进原辅材料国产化工作，大部分原辅材料已完成国产化替代，但国产原辅材料供应的稳定性、及时性还有待提高，少部分原辅材料参数要求偏高，现阶段依赖进口，这可能会对生产经营造成不利影响。

2、销售价格波动风险

当前，半导体行业市场需求仍然疲软，市场价格较前三年有所下降，特别是消费类电子的元器件价格显著下降，导致整体市场价格低迷。面对这种情况，业内企业纷纷通过降价来争夺订单和市场份额。公司为实现在现有市场份额基础上的增长，产品销售价格也将随市场情况有所调整。预计 2025 年公司产品销售价格将维持波动状态。

3、安全生产风险

由于公司生产工艺复杂，在生产中会使用操作难度高的大型设备、腐蚀性化学品等，对操作人员的技术要求较高且存在一定危险性。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用失误等意外事故，公司将面临安全生产事故、人员伤亡及财产损失等风险。

4、环境保护风险

公司生产过程会产生一定量的废水、废气、固体废弃物和噪声，需遵守环境保护方面的相关法律法规。随着国家对环境保护的日益重视，民众环保意识的不断提高，有关国家政策、法律法规的出台可能对公司的生产经营提出更为严格的要求。若公司不能及时对生产设施进行升级改造以提高对废水、废气和固体废弃物等的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，甚至发生环境污染事件，将给公司生产经营带来不利影响。

（四）财务风险

公司外销产品适用免抵退税相关办法，享受《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39 号）政策。有研硅及子公司山东有研半导

体适用《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额。子公司山东有研半导体享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）中相关企业所得税税收优惠政策，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。山东有研半导体享受《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行。若后续公司享受的税务优惠政策发生变动，公司可能存在税务成本增加的风险。

（五）行业风险

1、行业周期的风险

半导体行业增速与全球经济形势高度相关，呈现出周期性波动趋势；同时，半导体行业的周期性还受技术升级、市场结构变化、应用领域升级、自身库存变化等因素的影响。近年来，半导体行业新技术、新工艺的不断应用导致半导体产品的应用周期不断缩短。若半导体行业市场需求出现周期性下滑，则公司的经营业绩存在波动风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来随着我国对半导体产业的高度重视，在国家产业政策和地方政府的推动下，我国半导体硅材料行业新筹建项目不断增加。公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。国内半导体硅材料厂商在6英寸和8英寸硅片方面的产能扩张，导致产品价格竞争激烈，行业内企业盈利能力下降。因此，公司未来可能面临市场竞争加剧的风险。

（六）宏观环境风险

1、宏观经济风险

半导体产品应用领域广泛，涵盖通讯、人工智能、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域，因此半导体行业与全球宏观经济形势息息相关，宏观经济的波

动将直接影响半导体市场的供需平衡。若全球经济增速放缓、宏观经济出现较大波动，则半导体行业增速可能放缓甚至下滑，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、地缘政治格局风险

地缘政治格局的变化通过影响市场需求、贸易政策和国内竞争环境，对企业的业绩和市场策略产生影响。公司客户集中度相对较高，境外销售占一定比例，若未来主要客户所在国家或地区在贸易政策、关税等方面对我国进一步设置壁垒或汇率发生不利变化，且公司不能采取有效应对措施，将导致对公司经营业绩产生不利影响。

（七）其他重大风险

1、募投项目建设风险

公司募集资金投资项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”建设周期至2025年12月，项目在实施过程中可能受到工程施工进度、工程管理、设备采购、设备调试及人员配置等因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性，募集资金投资项目存在不能按期竣工投产的风险。

2、募投项目未能实现预期经济效益风险

本次募集资金投资项目从建设到产生收益需要一定时间，在项目实际实施的过程中，可能会面临整体经济形势、行业市场环境、技术革新等不确定因素，将会对公司募集资金投资项目的实施带来不利影响，并且半导体硅片行业受终端市场需求影响，未来所面临市场环境的不确定性也可能导致新增产能无法实现预期销售，从而影响募投项目预期效益的实现。

3、新增折旧影响公司盈利能力风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，导致折旧摊销等增长，公司固定生产成本和费用的增加。在募集资金投资项目完成后，若因管理不善或产品市场开拓不力而导致项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，新增固定资产折旧和摊销将加大公司经营风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

4、12英寸硅片项目的风险

通过参股公司山东有研艾斯布局 12 英寸硅片业务，由于山东有研艾斯前期投入资金较大，产线产能的爬坡和稳定量产需要一定的周期，加之下游客户认证的时间较长，如果未来山东有研艾斯出现较大的经营亏损，将对公司的产业布局 and 经营业绩造成不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

经查阅公司 2024 年年度报告，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	99,594.59	96,040.33	3.70
归属于上市公司股东的净利润	23,290.38	25,418.10	-8.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,302.23	16,500.37	-1.20
经营活动产生的现金流量净额	22,936.80	26,664.28	-13.98
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	434,158.70	414,799.84	5.27
总资产	536,776.84	504,305.63	6.44
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1871	0.2037	-8.15
稀释每股收益(元/股)	0.1871	0.2037	-8.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1310	0.1323	-0.98
加权平均净资产收益率(%)	5.51	6.23	减少0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.86	4.04	减少0.18个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	7.86	8.56	减少0.70个百分点

2024 年，伴随消费电子市场的改善以及 AI、电动汽车等领域的发展带动了计算芯片、功率芯片需求的增加，半导体硅片市场在 2024 年二季度有所恢复，行业整体需求好于 2023 年。但产品供需关系仍然失衡，产品价格下滑，出口市场受地缘政治影响仍然低迷，2024 年公司净利润，每股收益出现一定下滑。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、技术优势

公司是国内最早从事半导体硅材料研制的企业之一，主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售。公司技术团队承担了国家半导体硅材料领域的重大科技攻关任务，突破了半导体硅材料制造领域的关键核心技术，在国内率先实现了 6 英寸、8 英寸硅片、刻蚀设备用硅单晶材料的研制及产业化，刻蚀设备用硅材料技术达到国际领先水平。完成了具有自主知识产权的半导体硅材料技术布局，在主营业务领域取得多项发明专利，形成了较高的技术壁垒。

2、产品优势

公司主要产品包括 6-8 英寸直拉硅单晶及抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶及抛光片等，产品质量稳定，结构合理，可以满足不同客户对硅材料产品的需要。同时，面向半导体领域新应用场景，公司加强特色化产品的研发，具有快速响应市场需求的能力，持续保持产品的市场竞争能力和盈利能力。

3、国产替代

公司积极推动关键原辅材料和设备的国产化，加大国产替代力度，目前已接近全部国产化，在降低生产成本的同时，提升供应链的保障能力和安全性。

4、人才优势

公司高度重视人才梯队建设，主要核心技术人员均承担过国家重大科技攻关项目，拥有丰富的研发和工程化经验。目前公司有正高级工程师 17 名，其中 4 人享受政府特殊津贴。在人才培养方面，与清华大学、北京科技大学等联合培养工程硕士、工程博士，拓宽人才培养渠道，为公司发展提供强有力人才支撑。

5、客户优势

经过多年的市场积累，公司拥有深厚的客户基础，与客户建立了良好的沟通协调机制，能够快速、准确地了解客户需求，为客户提供最优质的服务。

(二) 核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出变化

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	7,828.07	8,222.21	-4.79
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	7,828.07	8,222.21	-4.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.86	8.56	减少 0.70 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

公司研发活动正常开展，研发投入总额不存在变化较大的情况。

(二) 研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	集成电路用硅单晶以及抛光片的研发	21,278.27	4,079.64	20,089.19	在研	依据新应用场景芯片对材料的需求，研发晶体材料生长技术和硅片制造技术，完成样品试制和客户验证。	国际先进，国内领先	存储、逻辑等结构器件

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
2	集成电路刻蚀设备精密部件用硅材料的开发	14,357	2,568.47	12,733.65	在研	开发集成电路刻蚀设备部件用大尺寸晶体材料生长及加工技术、完成样品试制和客户验证。	国际领先	刻蚀设备用硅部件
3	大尺寸区熔晶体材料的开发	4,330.2	1,084.44	4,533.14	在研	完成大尺寸区熔单晶的开发，重点解决大直径多晶处理、热场设计、拉晶工艺控制等技术问题。	国际先进、国内领先	LED 及光通信元器件、高压大功率器件
合计	/	39,965.47	7,732.56	37,355.99	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募投项目整体建设进度因半导体市场下行而放缓，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

本持续督导期间，除员工持股平台的股份减持外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股数量未发生变化，且不存在其他质押、冻结及减持情况。

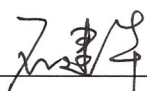
十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

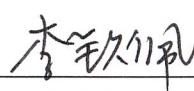
基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：


石建华


李钦佩

